

# 北京赛微电子股份有限公司

## 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将本公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准，2021 年公司向特定对象发行人民币普通股 90,857,535 股，发行价格为 25.81 元/股，募集资金总额为人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用 11,600,291.50 元（不含增值税），募集资金净额为 2,333,432,686.85 元。

该募集资金已于 2021 年 8 月 23 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2021]000007 号”《验资报告》。

#### （二）2023 年半年度募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金账户使用情况	金额
1、募集资金账户资金的减少项：	
(1) 以募集资金置换预先投入	192,999,801.24
(2) 对募投项目的投入	1,163,805,552.25
(3) 补充流动资金	505,622,320.79
2、募集资金账户资金的增加项：	
财务费用净收益	35,309,185.16
<b>截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额</b>	<b>506,314,197.73</b>

注：1、公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。公司以上述自筹资金预先投入募投项目

资金 19,299.98 万元于 2021 年 10 月 26 日完成置换。

2、向特定对象发行股票发行费用中尚有 585.03 万元未置换。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。

公司与中信银行股份有限公司北京分行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，与北京赛莱克斯国际科技有限公司、中泰证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金四方监管协议》，与赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司、中泰证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。

本公司及子公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

### （二）募集资金的存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

序号	开户行	账户类别	账号	余额
1	中信银行北京分行	募集资金专户	8110701013502121334	414,676,899.78
2	杭州银行北京分行	募集资金专户	1101040160001355881	0.00
3	宁波银行北京分行	募集资金专户	77010122001377768	0.00
4	宁波银行北京分行	募集资金专户	77010122001377977	1,340.07
5	杭州银行北京分行	募集资金专户	1101040160001356145	64,761.11
6	杭州银行北京分行	募集资金专户	1101040160001416204	4,905,398.13
7	宁波银行北京分行	募集资金专户	77180122000035187	92,516,090.14
合计				512,164,489.23

## 三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

**（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况**

本报告期不存在无法单独核算效益的募投项目。

**（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况**

本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。

**（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

公司于2021年10月26日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19,299.98万元，该金额经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天圆全专审字[2021]001537号”《北京赛微电子股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。

公司以上述自筹资金预先投入募投项目资金19,299.98万元于2021年10月26日完成置换。

**（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本报告期未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**（六）节余募集资金使用情况**

本报告期不存在尚未使用的节余募集资金。

**（七）超募资金使用情况**

本报告期不存在超募资金使用情况。

**（八）尚未使用的募集资金用途和去向**

本报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

**（九）募集资金使用的其他情况**

本报告期不存在使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

本报告期不存在变更募投项目的情况。

本报告期后，公司于2023年8月2日召开的第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永

久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中用于“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”的部分募集资金用途予以变更，即该募投项目募集资金投资规模由原计划的 32,580 万元缩减为 14,580 万元，并将变更的该部分募集资金 18,000 万元永久补充流动资金。公司于 2023 年 8 月 18 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了该事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

公司将该 18,000 万元永久补充流动资金。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司募集资金的存放和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

特此说明。

附表：募集资金使用情况对照表

北京赛微电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

附表:

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

单位: 万元

募集资金总额		233,343.27				本报告期投入募集资金总额	5,214.49			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	186,242.77			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目(2019 年、2021 年均融资投入)	否	79,051.98	79,051.98	-	79,289.30	100.30	2020 年 12 月 31 日	2,383.28	否	否
2. MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目	否	32,580.00	32,580.00	-	-	-	2023 年 12 月 31 日	-	否	否
3. MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目	否	71,080.00	71,080.00	5,214.49	56,391.24	79.33	2024 年 1 月 31 日	-	否	否
4. 补充流动资金	否	50,631.29	50,631.29	-	50,562.23	99.86	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	233,343.27	233,343.27	5,214.49	186,242.77	-	-	2,383.28	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司 2021 年(完成)向特定对象发行股票募集资金投资项目中:“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”同时为 2019 年(完成)非公开发行人股票募集资金投资项目,在 2019 年募集资金投资完成时已处于正常运营阶段(截至本报告出具日,北京 FAB3 已处于正常运营阶段并持续推进产能爬坡,但发展及实现效益的节奏慢于预期);“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”处于等待实施阶段(北京 FAB3 在自									

	主开发及积累工艺过程中，已进行高频通信 MEMS 器件的相关制造工艺研发工作，并已解决部分型号高频通信 MEMS 器件的相关制造工艺)、“MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目”处于建设阶段；“补充流动资金”已正常实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 19,299.98 万元，该金额经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天圆全专审字[2021]001537 号”《北京赛微电子股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。公司以上述自筹资金预先投入募投项目资金 19,299.98 万元于 2021 年 10 月 26 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于对应的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2023 年 8 月 2 日召开的第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十八次会议，2023 年 8 月 18 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中用于“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”的部分募集资金用途予以变更，即该募投项目募集资金投资规模由原计划的 32,580 万元缩减为 14,580 万元，并将变更的该部分募集资金 18,000 万元永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。 本次变更的原因：该项目由公司全资子公司赛莱克斯国际统筹协调，原计划组织公司全资子公司瑞典 Silex Microsystems AB 与公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）的境内外人才、工艺资源，以共同推进相关工艺开发，并在本土实现沉淀吸收。但本项目后续一直处于实施准备阶段，一直未使用募集资金，主要原因在于，一方面，募集资金到位后相关跨境工作的组织实施遇到外部障碍；另一方面，赛莱克斯北京在自主开发及商业活动中已成功积累相关工艺，高频通信 MEMS 器件的相关制造工艺研发工作已获得开展，部分型号高频通信 MEMS 器件的相关制造工艺已成功解决。 因此，结合公司实际经营情况、资金需求情况以及业务发展规划，为了提高公司募集资金使用效率，公司拟对用于该募投项目的部分募集资金用途予以变更，即该募投项目募集资金投资规模由原计划的 32,580 万元缩减为 14,580 万元，并将变更的该部分募集资金 18,000

	万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该项目剩余募集资金 14,580 万元后续拟继续用于更多型号高频通信 MEMS 器件的相关制造工艺研发。
--	---